



Regensburg - das mittelalterliche Wunder Deutschlands!

Lernen Sie das UNESCO Weltkulturerbe kennen und genießen Sie die bayerische Gastlichkeit.

Industrie- und Handelskammer Regensburg - Sitzungssaal - D.-Martin-Luther-Straße 12 93047 Regensburg

Organisation

Seminarmanagement

Dipl.-Phys. Helmut Reff
 OTTI, Seminare und Fachforen Bereich Technik
 Wernerwerkstraße 4
 93049 Regensburg
 Telefon +49 941 29688-34
 E-Mail: helmut.reff@otti.de

Zimmerreservierung

Hotel ACHAT Plaza
 Herzog am Dom
 Telefon +49 941 584000
 Sonderkonditionen für OTTI-Seminar Teilnehmer!
 www.achat-hotel.de
oder
 Tourist-Information Regensburg
 Telefon +49 941 507-4412
 Telefax +49 941 507-4418
 www.regensburg.de

Teilnahmegebühren und Leistungen

Bei Anmeldung bis 07.12.2009:
 Fachforum mit Grundlagen (2½-tägig): € 1160,00
 Fachforum (2-tägig): € 890,00

Bei Anmeldung danach:
 Fachforum mit Grundlagen (2½-tägig): € 1230,00
 OTTI-Mitglieder: € 1180,00
 Fachforum (2-tägig): € 960,00
 OTTI-Mitglieder: € 910,00

Der zweite Teilnehmer Ihrer Firma erhält **10 % Ermäßigung**, jeder weitere Teilnehmer Ihrer Firma erhält **20% Ermäßigung**.
 In der Teilnahmegebühr sind Pausengetränke, zwei Mittagessen, eine Stadtführung, ein Abendessen und ausführliche Tagungsunterlagen (auch auf CD) enthalten.

Weitere Seminare aus dem Bereich Technik sowie Veranstaltungen aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Management finden Sie auf unserer Homepage www.otti.de

Ja, ich nehme teil am OTTI-Fachforum Kleben in der Elektronik

- Fachforum mit Grundlagen (2½-tägig):**
01. bis 03. Februar 2010 in Regensburg (KET 3517)
- Nur Fachforum (2-tägig):**
02. bis 03. Februar 2010 in Regensburg (KEV 3547)

Name _____

Vorname _____ Titel _____

Telefon _____ Telefax _____

E-Mail _____

Abteilung/Funktionsbereich _____

Firma/Institution _____

Straße/Postfach _____

PLZ/Ort _____

Rechnungsadresse (nur bei Abweichung von der Anmeldeadresse)

Firma/Institution _____

Straße/Postfach _____

PLZ/Ort _____

Branche _____ Zahl der Mitarbeiter _____

OTTI-Mitglied Unternehmen aus Ostbayern

OTTI-Kundennummer _____

Datum _____ Unterschrift _____

Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI), Wernerwerkstraße 4, 93049 Regensburg

Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Teilnahmeunterlagen. Die Teilnahmegebühren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Veranstaltungseinlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei OTTI eingegangen ist. Etwaige Änderungen aus dringendem Anlass behält sich OTTI vor. Bei Stornierung der Anmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 bis 15 Tagen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 120,00. Bei späteren Absagen (ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn) oder bei Fernbleiben wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. Für Sach- und Vermögensschäden, welche OTTI zu vertreten hat, haftet OTTI – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg.



Foto: IFAM, Bremen

FRÜHBUCHERBONUS bis 07. Dezember 2009

Kleben in der Elektronik

02. bis 03. Februar 2010 in Regensburg

Optional buchbar mit Einführung **Grundlagen des Klebens**

01. Februar 2010 in Regensburg

www.otti.de



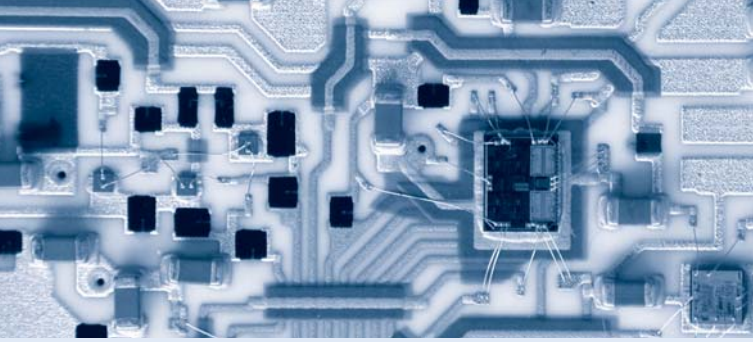


Foto: Continental AG

Programm

Grundlagen, (1/2-tägig)

01. Februar, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

1. Adhäsion, Oberflächen und Klebstoff-Chemie

- Oberflächen und Kontaminationen
 - Benetzung von Oberflächen
 - Verfestigung der Klebstoffe
- Dipl.-Ing. Andrea Paul

2. Elektrische, thermische, chemische und mechanische Eigenschaften von Klebstoffen

- Kraftübertragung
 - Verformungsfähigkeit
 - Spannungsverteilung in Klebungen
 - Temperaturabhängigkeiten
- Dipl.-Ing. Andrea Paul

3. Prüfung von Klebstoffen, Prozessen und Klebverbindungen

- Oberflächenkontrolle und -analytik
 - Qualität und Prozesskontrolle
 - Langzeitbeständigkeit und Alterung
- Dipl.-Ing. Andrea Paul

Fachforum (2-tägig)

02. Februar, 09:00 bis 17:45 Uhr

1. Klebe- und Dichtverbindungen in der Automobilelektronik

- Anwendungsgebiete für Klebeverbindungen
 - Einflussfaktoren und Anforderungen
 - Verbindungstechnik bei Klebungen
 - Anwendungsbeispiele
- Dr. Jens Heinrich

2. Schnelle Prozesse in der Elektronik

- Prozesse mit strahlungshärtenden Systemen
 - Prozesse mit Thermoaushärtung
 - Prozesse mit Induktionshärtung
- Dr.-Ing. Ralf Hose

3. Trends in der Verkapselung von mikroelektronischen Aufbauten

- Übersicht über aktuelle Verkapselungsverfahren
 - Chip on Board, Flip Chip, BGA etc.
- Dipl.-Ing. Tanja Braun

4. Damit es gut hält: Oberflächenanalytik beim Kleben in der Elektronik

- Anregungstiefe - Informationstiefe
 - Analytische Techniken
 - Fallstudien: Reinigung und Aktivierung von Oberflächen, Fehleranalytik
- Dr. Birgit Hagenhoff

5. Einfluss der Fließeigenschaften auf das Applikationsverhalten von Klebstoffen

- Fließverhalten und rheologische Phänomene
 - Einfluss der Rheologie auf das Applikationsverhalten (Sieb- und Schablonendruck, Stempeln, Jetten)
- Dr. Jana Kolbe

6. Kleben mit automatisierter Fertigungstechnik

- Lieferformen und Verarbeitung

- Mischen und Dosieren
 - Fügen und Nassklebkraft
 - Härten und Prüfen
- Betrw. Rainer Schobert

7. Klebungen in High-Power LED's

- Verhinderung von Kleberkriechen
 - Adhäsionssteigerung auf LF
 - Klebung von Optiken
 - Zuverlässige Prozessierung
- Dr. Michael Kruppa

03. Februar 08:30 bis 16:30 Uhr

1. Klebstoff Auftragsverfahren

- Techniken zur Klebstoffapplikation
 - Dispensen gefüllter Klebstoffe im Sub-Nanoliter-Bereich
 - Einfluss des Mikroblasengehalts
- Dr. Thomas Gesang

2. Auslegung von Klebverbindungen in der Mikrosystemtechnik

- Anforderungen bei Sensoren und Mikrosystemen
 - Modellierung und Simulation
 - Materialeigenschaften
 - Beispiele, experimentelle Verifikation
- Dipl.-Ing. David Pustan

3. Prozesssicherheit beim Einsatz von UV-härtenden Klebstoffen und Vergussmassen

- UV-härtende Klebstoffsysteme
 - Prozesssicheres Aushärten
 - Inline Härtungskontrolle
 - Anwendungsbeispiele
- Dr. Stefanie Wellmann

4. Qualitätssicherung

- Wareneingangskontrolle
 - Prozessbegleitende Qualitätssicherung
 - Langzeitbeanspruchung - beschleunigte Alterung
- Dr. Eberhard Ritzhaupt-Kleissl

5. Einsatz von thermisch leitfähigen Klebstoffen im Automotive Bereich

- Auswahl der Klebstoffe
 - Einfluss von mechanischen und thermischen Eigenschaften
 - Qualifikation der Klebstoffe
 - Praxisbeispiele
- Dr. Dragan Krecar

6. Stressarmes Packaging

- Microelectronic Packaging
 - Thermomechanischer Stress
 - Nachweismöglichkeiten
 - Stressarme Packagingvarianten
 - Anwendungsbeispiele
- Dipl.-Ing. Werner Schneider

7. Kleben und Elektronikschutz bestückter Baugruppen

- Kleben, Vergießen, Lackieren
 - Notwendigkeit der Bauteilfixierung
 - Einsatz von 1-k PUR und Schmelzharz
 - Methoden und Beispiele aus der Praxis
- Dipl.-Ing. Jens-Hendrik Klingel

Ihre fachliche Leitung



Dr. rer. nat. Thomas Gesang

Leiter Fertigungstechnologie und Klebtechnik für Mikrosysteme und Medizinanwendungen, Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen.

Nach dem Physikstudium erwarb Herr Dr. Gesang Industrieerfahrung in Cambridge/UK bei der Entwicklung optischer Systeme sowie des Druckkopfes eines Inkjet Printers.

Seit 1989 ist Herr Dr. Gesang am IFAM auf dem Gebiet der Klebtechnik tätig. Er ist seit seiner

Promotion am Fachbereich Chemietechnik der Universität Dortmund in vielen Industrie- und öffentlichen Projekten zuständig für das Kleben in der Mikrofertigung, Medizintechnik und Elektronik.

Ihre Referenten

Dipl.-Ing. Tanja Braun

Encapsulation Technologies, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM), Berlin

Dr. Birgit Hagenhoff

Geschäftsführung, Tascon GmbH, Münster

Dr. rer. nat. Jens Heinrich

Fertigungstechnologien, Continental Automotive GmbH, Regensburg

Dr.-Ing. Ralf Hose

Schulungsleitung, DELO Industrie Klebstoffe GmbH, Windach

Dipl.-Ing. (FH) Jens-Hendrik Klingel

Geschäftsführung, KC-Produkte GmbH, Frielzheim

Dr. Jana Kolbe

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen

Dr. Dragan Krecar

Technologie- und Prozessentwicklung, AB Mikroelektronik GmbH, Salzburg

Dr. Michael Kruppa

Backend Technology, OSRAM Opto Semiconductors GmbH, Regensburg

Dipl.-Ing. (FH) Andrea Paul

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen

Dipl.-Ing. David Pustan

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, IMTEK Institut für Mikrosystemtechnik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Dr. Ing. Eberhard Ritzhaupt-Kleissl

Research Scientist, Siemens AG, Erlangen

Dipl.-Ing. Werner Schneider

Verantwortlicher für Werkstoffe im Entwicklungsbereich, Microelectronic Packaging, Dresden GmbH

Betrw. (IHK) Rainer Schobert

Polymere Technologien, Polytec PT GmbH, Waldbronn

Dr. Stefanie Wellmann

Geschäftsführung, Wellmann Technologies GmbH, Friedelsheim

OTTI-Fachforum

Kleben in der Elektronik

01. bis 03. Februar 2010 in Regensburg

Grundlagen: (01. Februar 2010)

- Adhäsion, Oberflächen und Klebstoff-Chemie
- Elektrische, thermische, chemische und mechanische Eigenschaften von Klebstoffen
- Prüfung von Klebstoffen, Prozessen und Klebverbindungen

Fachforum (02. bis 03. Februar 2010)

- Verschiedene Klebstoffklassen und Füllstofftypen
- Automatisierte Fertigungstechniken zum Kleben
- Modellierung und Simulation
- Kleben versus Löten
- Sicherheit des Klebprozesses
- Oberflächenanalysetechniken zur Prozessentwicklung und Fehleranalytik
- Schadensanalyse an Leitklebverbindungen
- Thermisch leitfähige Klebstoffe

OTTI plus

Wichtige Kontakte knüpfen, Inhalte diskutieren, zwanglos Netzwerke aufbauen – profitieren Sie vom OTTI-Rahmenprogramm: zum Beispiel bei einer Stadtführung, einem gemütlichen Abendessen in gemeinsamer Runde, bei Kultur und Entspannung im Kreise der Seminarteilnehmer und Referenten.

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus der Entwicklung, Produktion und dem Qualitätsmanagement der Elektronik- und Elektrotechnikindustrie
- Ingenieure, Techniker, Chemiker und Materialwissenschaftler aus dem Gebiet der Klebstoffe und Vergussharze und deren Anwendungen